

# 2024年9月日本国际电子展-介绍

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 2024年9月日本国际电子展-介绍       |
| 公司名称 | 上海京硕展览有限公司              |
| 价格   | .00/件                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 龙阳路2345号                |
| 联系电话 | 18939750396 18939750396 |

## 产品详情

2024日本國際電子科技展覽會

NEPCON JAPAN

2024年09月04-06日（千叶）

2024年10月23-25（名古屋）

2025年01月22-24日（东京）

展會規模：約1200家參展商；參觀人數：約50000名；

主辦單位：勵展博覽集團日本株式會社

組展單位：上海貿升展覽服務有限公司--日本展會專業服務商

### 展會介紹

作為「電子研發，製造與封裝技術」的綜合展會，NEPCON JAPAN隨著日本及亞洲電子行業的發展不斷成長壯大，至今已走過30多個年頭。展會由電子產品製造設備及部件技術展，電子零部件檢測設備及開發技術展，電子零部件封裝設備及開發技術展，印刷電路展，電子元件及材料展，精密加工技術展這6個專業展會組成。是名副其實的「代表亞洲電子產業」的綜合性展覽會。NEPCON JAPAN作為了解「未來電子產業」新技術的絕佳場所而備受業界矚目，吸引越來越多來自全球的參展商與觀展人士匯聚一堂！

### 市場介紹

日本是一個高度發達的資本主義國家。其資源匱乏並極端依賴進口，發達的製造業是國民經濟的主要支

柱。科研、航天、製造業、教育水平均居列。此外，以動漫、遊戲產業為首的文化產業和發達的旅遊業也是其重要象征。據調查，日本在環境保護、資源利用等許多方面堪稱世界典範，其國民普遍擁有良好的教育、極高的生活水平和國民素質。日本是電子工業強國，隨著近年來人工智能電子工業的不斷發展，日本本土的電子製造業呈現出衰退的趨勢，由過去的銷售快速增長到現在的依賴于電子核心部件、上游化學材料保有優勢。在返個過程中，日本市場呈現出新的需求，為中國的整機產品、配套產品製造企業打入日本市場帶來了良好的契機，同時也帶來了廣闊的合作機遇。據日本海關統計，2019年1月，日本與中國雙邊貨物進出口額為764.0億美元。其中，日本對中國出口340.5億美元，總額增長14.2%；自中國進口423.5總額增長7.0%。日本與中國的貿易逆差83億美元。中國是日本第二大出口目的地。

## 構成展會

NEPCON JAPAN日本電子科技博覽會由六大專業展會組成：

### 1、電子產品製造設備及部件技術展 INTERNEPCON JAPAN

匯集了各種電子產品製造及SMT所用設備、解決方案、技術及服務。

### 2、電子零部件檢測設備及開發技術展ELECTROTEST JAPAN：

亞洲領先的電子研發製造領域有關測試，檢查，測量和分析技術的專業展會。

### 3、電子零部件封裝設備及開發技術展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXP

亞洲領先的集成電路製造展！匯集了各種先進的設備、材料及服務。

### 4、電子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO

亞洲領先！匯集各種電子元件和材料

### 5、印刷電路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo

裝配設備、保證材料/組件、IC封裝匯集了如PCB材料，設計開發委托服務與設計工具軟件等各種PCBs/PWBs及技術。

### 6、精密加工技術展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO

電子製造領域精密加工技術專門展！諸如模具製造、切削、沖壓加工、蝕刻等各種精密·微細加工技術匯聚一堂！

## 展覽範圍

電子產品製造設備及部件技術展 INTERNEPCON JAPAN：貼片機、點膠機、焊接設備/材料、封裝設備、清洗設備、激光加工機、EMS/電子代工服務、清潔/靜電防護器材、工廠/廠房設備

電子零部件檢測設備及開發技術展ELECTROTEST JAPAN：各種檢測設備、X射線檢測設備、測試儀器、分離設備/軟件、可靠性/評估檢驗設備、CCD相機、無損檢測設備、合同分析服務

電子零部件封裝設備及開發技術展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXPO：裝配設備、包裝材料/組件、IC封裝分析/模擬軟件、SATS/契約設計服務、電鍍/蝕刻材料及設備、MEMS設備/封裝設備

電子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO：接線器、線纜、傳感器、接線端

子、電源開關、電阻器、轉換器、電路安裝材料、納米技術材料

印刷電路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo：裝配設備、保證材料/組件、IC封裝分析/模擬軟件、半導體器件/檢測設備、SATS/契約設計服務、電鍍/蝕刻材料及設備、MEMS設備/封裝設備

精密加工技術展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO:沖壓加工、切削/鉗孔、精密/微細鈹金加工、金屬成型、電鑄、精密鑄造、鏡面磨削、鐳射加工、模塑、難切削材料加工